

SAM-8

セミオートウェーハマウンター

Semi-Automatic Wafer Mounter with Vacuum Chamber

【概要 - Outline -】

◆ダイシング前工程としての専用フレームへのウェーハマウントするセミオート機です。

Semi-automatic wafer mouter which mounts wafer & tape on film frame for dicing process.

真空チャンバー使用によりマウント中にダメージを与えません。

Vacuum chamber makes no damage onto wafer in mounting.

【特長 - Features -】

◆ウェーハを真空状態でテープに貼り付けることにより、気泡の発生が無く、ウェーハにダメージも与えません。

No air bubble, nodamage for wafer by mounting wafer in vacuumed atmosphere.

◆ウェーハパターン面、外周 3mm 以外保持によるコンタクトレステーブルを採用。(ウェーハ吸着は不要です。)

Contactless mounting table which holds wafer at 3mm edge part. (the vacuum to hold wafer is not necessary.)

◆ウェーハマウント位置と、フレームテープ貼り付け位置を別々に配置することにより、テープの使用量が

Saving tape consumption, possible to set other frame in wafer mounting,

少なく済み、1枚のウェーハマウント中に別の1枚のフレームのセッティングが可能で、作業効率も上がります。

contributing operation efficiency by separating wafer mounting part.

◆テープの送り、巻き取り、カットは自動で、離ケイ紙巻き取りシステムも可能です。(UVテープ使用可能)

Automatic tape supply, tape coiling, wastage tape coiling, tape cutting. (UV tape applicable)



仕様 Specification		SAM-8
対応ウェーハサイズ Wafer Size		4・5・6・8 inch
フレームサイズ Frame Size		2-6-1 / 2-8-1
タクトタイム Throughput		35 秒 / 枚 (2枚目以降セット時間除く) (ご使用条件により異なります) 35 sec/wafer (from 2nd wafer expect the operator is handing time) (Depend on data setting)
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V 単相 Single phase 50/60Hz 1.5KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 30NI/min
	真空減 Vacuum source	コンバム使用 Using venturi valve
装置寸法 Demension		W 810 × D 1,330 × H 1,480 mm
重量 Weight		365 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.